

中国社と汎用曲げ加工機

吉野機械、世界で展開



センフェンと共同開発したパネルバンダー

吉野機械製作所（千葉市緑区、吉野友章社長）は、中国のレーザー加工機メーカーである済南森峰激光科技（センフェン、山東省）と業務提携する。汎用性の高いパネルバンダーを共同開発し、世界展開する。受注生産中心から汎用性のある製品のラインアップを拡充し新たな成長につなげる。今後、連携を強化するため合併会社の設立も検討している。

吉野機械とセンフェンは板金を自動で折り曲げる機械「パネルバンダー」シリーズブランド「BENDRA」を10月初旬に投入する予定。第1弾として「フレキシブル（ワーク）をしっかりとつかんで、所定の位置に送り込む「クランプアーム送り方式」で薄板や大型ワークの曲げ加工に適している。

同一ワークの量産曲げから多品種ワークの自動化まで対応。高い機械剛性と省スペースを両立する。段取り・加工中の手作業を低減し、曲げ精度の安定化と製品の均一性を高める。吉野機械が独自開発した全自動工具長切り替えシステムを搭載し、従来の手動だった工具有効長の切り替えを自動化する。同システムは工具そのものを交換するのではなく、曲げ長さに応じて上部クランプ金型の有効長を自動的に切り替える。

センフェンの中国にある生産拠点で製造する。吉野機械が日本と韓国で、センフェンが米国やドイツ、インド、ベトナムなどで販売する。両社は今後、市場ニーズを踏まえながら、BENDRAシリーズのラインアップを順次拡充する方針。吉野機械は2035年に売上高100億円（27年3月期は20億円の見込み）を目指しており、今回の提携もこの一環となる。